

苏州国芯科技股份有限公司

关于自愿披露公司研发的汽车电子车身及网关控制 MCU 新产品内部测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC2012BC”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

一、新产品的基本情况

公司成功研发的CCFC2012BC芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代汽车电子中高端车身及网关控制芯片，是在已有CCFC2002BC芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善，可以根据需求形成不同资源的再配置，从而增加了产品的应用覆盖面，封装形式包括LQFP176/144/100/64等，可实现对国外产品如NXP(恩智浦)MPC5604BC、MPC5607B系列以及ST(意法半导体)的SPC560B50、SPC560B64系列相应产品的替代。芯片具备多种独立的汽车标准通讯接口FlexCAN(8路)、LINFlex(10路)以及对外控制接口eMIOS(64个)和串行通讯接口DSPI(6路)，芯片还配置了较大容量的存储空间，其中程序存储FLASH最高配置可达1.5M字节，数据存储最高配置FLASH最高可达128K字节，内存空间最高配置可达128K字节，另外芯片具有两个多通道ADC(数模转换)控制电路。CCFC2012BC芯片按照汽车电子等级进行设计和生产，可以广泛应用于车身控制和网关以及新能源车的整车控制，有望为解决我国汽车产业“缺芯”问题作出贡献。

二、对公司的影响

公司上述芯片产品具有完全自主知识产权，并采用和国内头部车身控制模组厂商协同创新的合作方式，产品开发阶段就受到国内汽车整机厂商和 Tier1 汽车电子模组厂商的关注和订单支持，该款新产品截至 2022 年 4 月 7 日公司已获得 9 家客户实际订单超过 110 万颗。该款新产品的研发成功进一步丰富了公司的汽车电子车身及网关 MCU 产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。

三、风险提示

本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作已经在开展进行中。本次公司推出的新产品 CCFC2012BC 汽车电子 MCU 芯片在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日